

Trias 企業メモ 2010-02-09

(6920 JASDAQ)レーザーテック株式会社
2010年6月期 第2四半期決算説明会サマリー

2010年2月3日、レーザーテック株式会社(以下、レーザーテック)の2010年6月期 第2四半期決算説明会が開催されましたので、概要をご案内いたします。

説明会出席者:

代表取締役社長 岡林理氏、取締役 内山秀氏、財務経理部長 塚崎健明氏、企画 IR 室長 浅井浩志氏

岡林社長による決算説明の概要は以下の通りです。

【第2四半期決算概要】

2010年6月期第2四半期累計(2009年7-12月期、上期)の売上高は、前年同期比 18%減の 3,660 百万円、営業損失は 80 百万円となった(前年同期は 247 百万円の赤字)。半導体関連装置売上的大幅な伸びと固定費削減効果により、従来予想の 230 百万円の赤字に対しては上方修正。受注高は半導体の微細化投資の回復による関連装置の受注が大きく伸び、前年比 61%の増加となった。営業キャッシュフローは黒字に転じた。



(表 1)製品別 売上高・受注動向

連結 (百万円)	09年6月期2Q(累計)			10年6月期2Q(累計)					
	受注高	売上高	受注残高	受注高	前年 同期比	売上高	前年 同期比	受注残高	前年 同期比
半導体関連装置	1,025	1,197	1,543	2,433	137%	1,905	59%	2,042	32%
FPD関連装置	635	2,559	5,269	704	11%	1,079	-58%	3,191	-39%
レーザー顕微鏡	224	234	167	211	-6%	154	-34%	103	-38%
サービス	537	478	145	551	3%	520	9%	143	-1%
合計	2,421	4,469	7,124	3,900	61%	3,660	-18%	5,481	-23%

2009年7月に開発体制を刷新。上期は 1)既存分野の強化、2)既存分野の周辺領域への拡大、3)新規分野の開拓、を開発方針に掲げ、それぞれ新製品を投入し受注活動を推進した。1)ではデバイスの微細化に対応した短波長レーザーによる最先端フォトマスク欠陥検査装置「X700」シリーズ、2)ではフォトマスクのヘイズ(フォトマスク表面に付着した化学物質による成長性異物)除去システム「PROMAHAZE」、3)では卓上型太陽電池変換効率分布測定機などを発売した。

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

【市況の見方と通期業績予想】

先端デバイスメーカーによる半導体の微細化投資は既に増加し始めている。DRAM を中心としたメモリー関連投資は 2008 年秋のリーマンショック以前から止まっていたが、昨年からのメモリー価格上昇と稼働率向上に伴い、メモリーメーカーに於いても微細化投資は増加傾向にある。ただし、新規生産設備への投資は限られている。フラットパネルに関しても工場稼働率は高いが、中国が中心となるであろう次期液晶パネルの大型投資の時期は依然不透明である。太陽電池等エネルギー・環境関連の投資は、足踏みはあっても中長期的に確実な拡大が予想される。

こうした市況を踏まえ、レーザーテックは微細化投資向け半導体関連製品等へのフォーカスにより、通期は前年同期比 88%の受注増、5%の売上増を目指す。地域別では韓国向け売上の伸びが大きい。通期で黒字転換(営業利益 430 百万円)との期初予想は変更しない。

(表 2)製品別 売上高・受注予想

連結 (百万円)	09年6月期			10年6月期 予想					
	受注高	売上高	受注残高	受注高	前年 同期比	売上高	前年 同期比	受注残高	前年 同期比
半導体関連装置	2,638	2,839	1,514	5,530	110%	5,680	100%	1,364	-10%
FPD関連装置	1,292	4,919	3,567	2,870	122%	2,600	-47%	3,837	8%
レーザー顕微鏡	467	599	46	550	18%	460	-23%	136	196%
サービス	935	908	113	1,050	12%	960	6%	203	80%
合計	5,334	9,266	5,240	10,000	87%	9,700	5%	5,540	6%

【質疑応答】

- Q1. 業績の本格回復には液晶用大型フォトマスクの売上回復が不可欠と思うが、液晶用大型マスク検査装置の回復なくして売上・利益は維持できるのか。過去のピーク時のような 30 億円レベルの営業利益計上は難しいのではないかと。
- A1. 今期の売上に関しては、半導体関連の新製品でカバーできる見込みだ。次期大型液晶設備投資は中国を中心に展開されるとみられ、中国での大型マスクの需要は増える。8G パネル工場については、すでに幾つかの中国国内メーカーに認可もあり、中国や中国以外的大型マスクメーカーから 51MD(8G 用大型マスク検査装置)等の引き合いもある。但し、パネル工場の認可の有無や、工場建設計画の具体的な時期等、不明なことが多く、また韓国や台湾の液晶マスクメーカーの中国進出についても、中国政府のスタンス次第という面が大きく、時期等含めてまだわからない。当面は、半導体関連中心に業績向上を図る。
- Q2. 半導体・液晶関連装置の売上の内訳は？
- A2. 半導体関連装置は上期 19 億円のうち約 70%がマスク検査装置、約 20%がマスクブランクス検査装置、残りはその他。通期予想 57 億円のうち約 60%がマスク検査装置、約 30%がブランクス検査装置。液晶関連は上期 11 億のうち約 90%がカラーフィルター修正装置で残りが大型マスク検査装置、太陽電池用装置等。通期予想の 26 億円は 80%がカラーフィルター修正装置と予想する。

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

- Q3. 中長期的な新製品開発の方向性は？
- A3. 半導体設備投資は今後も微細化投資が中心になると思われるので、引き続き最先端フォトマスク検査装置、ヘイズ除去装置のポテンシャルは大きいと見ている。2013年量産化と言われている EUVL(Extreme UltraViolet Lithography: 極端紫外線を用いた縮小露光) や 3次元デバイス - TSV (Through-Silicon Via: Si貫通電極) も必ず伸びる分野であり、これらの市場に注力していく。
- Q4. ヘイズ除去の市場サイズをどれくらいと見ているか？
- A4. マスク検査装置の市場は200-300億円とみられ、うち100億円がマスクメーカー側の市場とすると、残りデバイスメーカー側での検査市場がレーザーテックのターゲットとなる。このマスク検査関連分野で、数十億円の売上は確保できると見ている。ヘイズ除去装置(「PROMHAZE」)は現在デモを始めているところであり、顧客によりヘイズの発生状況も異なり、使用頻度や必要台数も異なってくる。市場規模はこれからはっきりしてくる。
- Q5. 新社屋費用の転換社債の償還原資に問題はないか。
- A5. 2010年12月末に償還を迎える残高が40億円あるが、メインバンクによるシンジケートローンにより、借り換えの用途は付いており問題はない。
- Q6. 12月発売の新製品「SICA61」(パワーデバイス用新素材 SiC(炭化ケイ素)ウェハの検査装置)はいつから売上に貢献するのか。
- A6. 受注は今期に計上される見込みだが、売上は検収基準のため時間がかかることもあり、売上が今期中に計上できるかについてはまだ分からない。
- Q7. HDD関連のビジネスチャンスはあるか。
- A7. 通常のハードディスクドライブのガラス基板検査は要望もあるが、他社でも出来るため、価格競争になるかもしれないので参入していない。ケミカル研磨材の評価等で少し経験はあるが、あまり注力はしていない。ただし、ナノインプリント技術(金型に刻み込んだ寸法が数十nm~数百nmの凹凸を、基板上に塗布した樹脂材料に押し付けて形状を転写する技術)を使うような新たな分野では、微細欠陥検出ニーズがあると思われるので、市場性について再度調査を行いたいと思う。

(以上)

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

【ご参考】

(6920)レーザーテック株式会社

連結主要指標と業績の推移

連結主要データ		
発行済み株式数(株)	2009.12月	11,785,800
うち自己株式数(株)	2009.12月	522,727
時価総額(百万円)	2010.2.8	13,766
一株当純資産(円)	2009.6月	1,058.5
ROE(%)	2009.6月	△ 5.2
ROA(%)	2009.6月	△ 3.1
PER(倍)	2010.6月予	65.8
PCFR(倍)	2009.6月	△ 76.5
PBR(倍)	2009.6月	1.1
株価(円)	2010.2.8	1,168
単元株数	2009.12月	100
日々平均出来高	2010.2.8	30,508

連結主要データ		
総資産(百万円)	2009.6月	19,867
自己資本(百万円)	2009.6月	11,922
有利子負債(百万円)	2009.6月	6,100
自己資本比率(%)	2009.6月	60.0
有利子負債比率(%)	2009.6月	51.2
フリーキャッシュフロー(百万円)	2009.6月	△ 1,726

注: ROE=当期純利益÷期首と期末の自己資本の平均

ROA=当期純利益÷期首と期末の総資産の平均

PCFR=時価総額/(当期純利益+減価償却費)

日々平均出来高=過去1年間の平均

有利子負債比率=有利子負債÷自己資本

フリーキャッシュフロー(FCF)=営業CF+投資CF

連結(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益	一株益(円)	一株配(円)
2006年6月期	12,033	2,963	3,060	1,884	162.3	40.00
2007年6月期	15,874	3,895	3,895	2,375	203.8	60.00
2008年6月期	14,136	3,100	3,156	1,888	165.2	50.00
2009年6月期	9,266	△ 657	△ 659	△ 651	△ 57.8	15.00
2010年6月期第2四半期	3,660	△ 80	△ 61	△ 96	△ 8.5	-
予2010年6月期	9,700	430	370	200	17.8	15.00

注 2010年6月期予想は、2010年2月1日発表の会社予想

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。